



imaps-France infos

N° 38, mai 2010

Rédaction Jean-Paul Droguet

49 rue Lamartine - F-78000 Versailles

Le mot de la Présidente, Brigitte Braux

Après quelques semaines de trêve pour notre association, les événements Imaps sont de nouveau prêts afin de vous faire partager des nouvelles de notre métier : la microélectronique et le micropackaging.

C'est en Juin que nous vous donnons rendez-vous pour deux événements forts.

A Paris, avec la participation d'Imaps au CIEN, le nouveau point de rencontre de toutes les industries électroniques françaises : nous avons jugé que l'Imaps ne pouvait être en dehors de ce grand rassemblement car nos métiers sont directement liés à la filière électronique.

La volonté de participer au travers de journées de tutoriaux est également liée au fait qu'il nous semble que les métiers de la Technologie microélectronique ne sont pratiquement plus enseignés et la plupart d'entre nous ressentons un manque dans la future génération d'ingénieurs : nos successeurs ont du mal à se former et nous-mêmes n'avons que peu de temps à consacrer à la formation.

Nous espérons que cette initiative sera reçue très positivement, je vous rappelle que l'Imaps est une association dont l'une des missions premières est le transfert du savoir-faire entre générations.

A Grenoble, le 24 juin, comme nous l'avions déjà fait par le passé, nous nous associons à MINATEC pour la semaine de cross roads avec une journée proposée par Imaps sur les Embedded Wafer Level technologies : une vision très future pour beaucoup d'entre nous mais à laquelle il est bon de se préparer car ces nouvelles techniques requièrent un long travail de développement avant de passer à maturité, dans le domaine industriel. Venez donc rêver un peu avec nous !
Cordialement.

Brigitte Braux
Présidente IMAPS France

Calendrier IMAPS France 2010 - 2011

<p>1er, 2, 3 juin 2010, Paris Participation au CIEN Expo Parc des Expositions Porte de Versailles</p>
<p>24 juin 2010, MINATEC, Grenoble Journée IMAPS-LETI "Embedded Wafer Level Packaging"</p>
<p>7 Septembre 2010 Assemblée Générale FOREST HILL "Paris, Meudon, Vélizy"</p>
<p>18 novembre 2010, Tours Journée Puissance en Microélectronique</p>
<p>9 Décembre 2010, Paris Journée Connectique</p>
<p>2-3 février 2011, La Rochelle 6e ATW Européen Micropackaging et Management Thermique</p>

CIEN Paris

Le Carrefour de l'Industrie Electronique et Numérique se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles les **1er, 2 et 3 juin**.

Résultant de la fusion du Forum de L'Electronique et de RF&Hyper Europe, le CIEN marque la volonté des syndicats professionnels concernés de créer un nouvel événement fédérateur annuel.

INTERCONEX a réuni quatorze exposants pour participer à l'exposition sous pavillon IMAPS.

En parallèle une salle de conférence a été réservée au **Pavillon 7 niveau 3** pour un cycle technique IMAPS, de formation (tutorial), sur les trois journées.

Mardi 1er juin
Technologies d'Interconnexion et de Packaging
par Jean-Marc Yannou YOLE Développement

Mercredi 2 juin

Co-industrialisation pour les PCB HDI en applications HF
par Sylvain Leroux JETWARE

Jeudi 3 juin

Le brasage des composants électroniques par Daniel Muller IFTEC

Horaires des 3 journées :

10h00-12h30 et 13h30-16h00

Déjeuner 12h30-13h30 libre + Visite Salon CIEN Pavillon IMAPS

Tarifs :

(Envoi d'une facture faisant ressortir la TVA 19,6%)

Membre IMAPS

(N° de membre A020.....) à jour de cotisation au moment de l'inscription

Prix par journée 400,00 € HT

Non membre IMAPS

Prix par journée 500,00 € HT

INSCRIPTION

Si vous n'avez pas reçu la fiche d'inscription, prenez contact, dès que possible :

Florence VIRETON Responsable Salon IMAPS/INTERCONEX
49 rue Lamartine 78035 Versailles France
Tél: 33 (0) 1 39 67 17 73 Fax: 33 (0) 1 39 02 71 93
Portable : 33 (0) 6 82 03 08 87 email: imaps.france@imapsfrance.org

Conditions d'inscription :

Nombre de places limité : Les inscriptions se feront sur la base du premier arrivé, premier servi.

L'organisation se réserve le droit d'annuler tout ou partie de la manifestation. Remboursement du coût de la formation sans indemnité.

Ces trois journées sont éligibles à la formation : INTERCONEX organisme de formation

N° agrément 11780608378.

Demandez une convention de formation et une attestation de présence.

Paiement et coordonnées bancaires d'INTERCONEX :

Pas de carte de crédit, règlement par chèque, espèces ou virement bancaire.

BNP PARIBAS VERSAILLES ETATS GENERAUX. Agence 00859 Code banque 3004

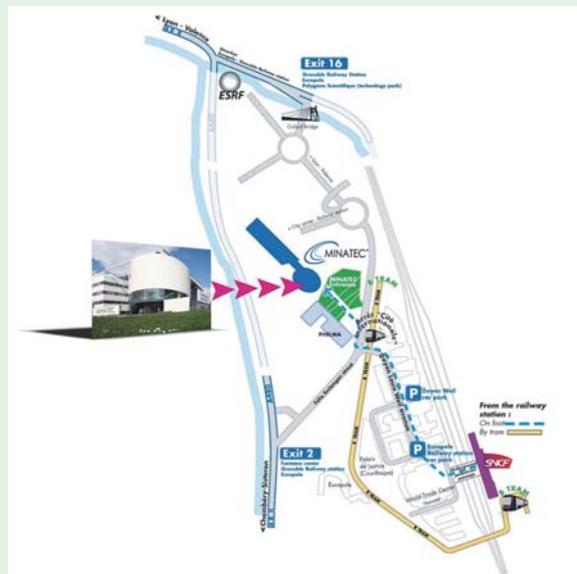
Compte 00010022786 Clé Rib 63. IBAN FR 76 3000 4008 5900 0100 2278 663 BIC BNPAFRPPVRS

Journée "Embedded Wafer Level Packaging"



Organisée avec le LETI, dans le cadre des « **MINATEC Crossroads** », cette journée de technologie avancée se déroulera le **24 juin sur le site MINATEC, 3 Parvis Louis Néel, à Grenoble.**

Il convient de rappeler la grande facilité d'accès au site MINATEC, proche de la gare ferroviaire de Grenoble et accessible aussi par autoroute depuis les aéroports de Lyon et Grenoble.



Comme nous l'avions écrit dans notre édition de mars, les troisièmes MINATEC Crossroads, du 21 au 25 juin 2010, devraient accueillir un millier de personnes, dont deux cent cinquante visiteurs venus du monde entier, ainsi qu'une centaine d'orateurs français et étrangers.

C'est donc au milieu d'un bouquet d'une douzaine d'événements, consacrés à la recherche fondamentale, aux applications industrielles et à l'enseignement dans le domaine des micro et nanotechnologies qu'IMAPS



France, associée au LETI, organisera, le 24 juin, un workshop dédié aux technologies émergentes de packaging et interconnexion. Sous le titre "**Embedded Wafer Level Packaging Workshop**", la journée comportera dix présentations orales en deux sessions.

La demande croissante de produits portatifs et la nécessité de disposer d'objets plus petits, plus légers et meilleur marché expliquent les progrès rapides des technologies de packaging au niveau de la tranche de silicium (Wafer Level Packaging ou WLP). Le packaging enfoui dans le substrat (Embedded Wafer Level Packaging) permet d'améliorer très sensiblement le niveau d'intégration au niveau de la puce ou du système. L'objectif de ce workshop est de donner une vision des technologies «Embedded WLP » dans plusieurs domaines d'application. Les principaux acteurs européens présenteront l'état de l'art et les nouvelles solutions envisagées, leurs avantages potentiels et leurs contraintes de mise en oeuvre.

Nous vous rappelons ci-dessous le programme technique de la journée qui a été diffusé à la fin du mois de mars après parution du magazine :

Salle B222 au 1er étage

8h15 - Welcome and opening

8h30 - Fan-out WLCSP and chip embedding: two different technologies with similar benefits – J.M.Yannou – Yole Développement

Session 1: Fan out

9h00 - Embedded Wafer Level Packaging – X.Baraton, Y Jin, J.M Garnier, E. Saugier, R.Coffy – ST Microelectronics

9h30 - Embedded Wafer Level Ball Grid Array (eWLB) – T. Meyer, G. Ofner, K. Pressel, B. Römer – Infineon Technologies AG (Germany)

10h00 - Wafer Level embedded System in Package (WLeSiP) for 3D Packaging Solution In -Soo Kang - Semiconductor R&D Division, NEPES Corporation (Korea)

10h30 - 11h00 Break

11h00 - "CIWIS" and "Viabelt" a 2D and 3D technologies which allow integration of multi-source Know Good Dies at the wafer level – J.C Souriau, N.Sillon, G. Poupon – CEA-LETI Minattec

11h30 - High performance and high reliability WLP Silicon passives for miniature medical devices – Franck Murray, Catherine Bunel - IPDIA

12h30 - 14h00 Lunch

Session 2: Chip Embedding

14h00 - Introduction

14h15 -The Next Generation of System-in-Package Technology by Chip Embedding - A. Ostmann, L.Boettcher , D. Manassis and S. Karaszkiwicz - IZM and TUB (Germany)

14h45 - Stacking of Known Good Rebuilt Wafers without

TSV - Applications in industrial domains - P. Couderc, N. Boulay, Dr C. Val – 3DPlus

15h15 Ultra Thin Chip Embedding as Enabling Technology for system integration - E. Beyne - IMEC

16h00 – 16h15 Break

16h15 -Embedded packages, an emerging new package platform – C. Beelen-Hendrikx – NXP

16h45 – Embedding as a packaging solution - N. Haslebner, M.Morianz, J.Stahr, Ch. Schwald ATS

17h15 - Conclusions

Les membres IMAPS bénéficient d'un tarif préférentiel :

Membre IMAPS 120 €

Non membre 150€

Le déjeuner (30€) n'est pas inclus.

Retenez dès à présent la date du **24 juin** car le nombre de place est limité.

Les inscriptions et paiements se font directement sur le site ci-dessous :

www.minattec.congress-scientifique.com:crossroads2010

Pour toute question ou difficulté contacter **Florence Vireton** Imaps.france@imapsfrance.org

Tél. 01 39 67 17 73

Assemblée Générale et Comité Directeur

L'Assemblée Générale des membres d'IMAPS France se tiendra le **7 septembre** après midi. Elle sera précédée, le matin comme les années précédentes, par une réunion du Comité Directeur de l'association.

Nous attirons votre attention sur le changement de lieu. L'Assemblée Générale 2010 et Le Comité directeur se réuniront à l'hôtel **Forest Hill «Paris, Meudon, Vélizy »** accessible par la voie rapide 118 (sortie N° 3, Meudon, Velizy).

Le vote par correspondance, pour le renouvellement annuel d'un tiers des membres du Comité Directeur, sera organisé en juin et dépouillé au début de juillet. Les résultats seront présentés en assemblée générale.

Journée Puissance en Microélectronique, 18 novembre 2010 Tours

Le succès de la journée organisée le 25 novembre 2009 à Talence, avec le Laboratoire IMS, dont nous avons rendu compte dans le numéro précédent, a conduit IMAPS France à reprendre le thème de « La Puissance en Microélectronique » avec le Laboratoire de Microélectronique de Puissance, de Tours où se dérou-

lera le **18 novembre** l'édition 2010. L'appel à communication a été diffusé.

Le Comité Technique attend des propositions de présentation orale (15 minutes + 5 minutes de questions) sur les thèmes suivants :

- Gestion énergétique des systèmes,
- Nouveaux matériaux pour l'électronique de puissance,
- Nouvelles applications de l'électronique de puissance :
 - Du véhicule hybride à la voiture électrique,
 - L'éclairage par LEDs de puissance,
 - La dissipation thermique dans les applications mobiles,
 - Electronique et photovoltaïque.
- Technologies innovantes d'interconnexion et d'assemblage pour fortes puissances, fort courant, haute tension,
- Fiabilité, retour d'expérience,
- Sensibilité des composants actifs de puissance à l'environnement radiatif naturel (protons, neutrons) et modes de défaillance.

Les auteurs qui souhaitent faire une présentation sont invités à faire parvenir une proposition résumée sur une page, sous format Word, avec les indications suivantes : Le nom de la société, le nom du conférencier, les auteurs associés, le titre de la conférence et le texte résumé.

La date limite d'envoi est le **3 septembre 2010**.

L'acceptation des propositions sera notifiée par le Comité technique le **16 septembre 2010**.

Merci d'envoyer les courriers à :

IMAPS Comité technique, Florence VIRETON

E-mail : imaps.france@imapsfrance.org

Journée Connectique

Paris, Espace Hamelin

Comme annoncé en mars, IMAPS France organise une journée technique dédiée aux connecteurs et aux technologies de connectique dont l'impact sur les performances, la fiabilité et les coûts des systèmes sont unanimement reconnus.

Organisée avec le GIXEL, elle se tiendra, le **9 décembre 2010** dans les locaux de l'**Espace Hamelin, 17 rue Hamelin à Paris** dans le 16^e arrondissement. La miniaturisation, la montée en fréquence ou en débit de données numériques et la tenue aux contraintes d'environnement ne font qu'accroître le besoin de solutions connectiques appropriées aux divers domaines d'application.

L'appel à communication a été diffusé.

Tous les types de connectiques sont concernés :

- Haute densité, forte puissance, haut débit, RF ou hyperfréquences, optique,
- Fixes ou démontables

- Applications aux télécommunications, à l'automobile, aux systèmes militaires, aéronautiques ou spatiaux,
- Fiabilité et retour d'expérience

Les auteurs qui souhaitent faire une présentation sont invités à faire parvenir une proposition résumée sur une page, sous format Word, avec les indications suivantes : Le nom de la société, le nom du conférencier, les auteurs associés, le titre de la conférence et le texte résumé.

La date limite d'envoi est le **3 septembre 2010**.

L'acceptation des propositions sera notifiée par le Comité technique le **16 septembre 2010**.

Merci d'envoyer les courriers à :

IMAPS Comité technique, Florence VIRETON

E-mail : imaps.france@imapsfrance.org

6e ATW Européen Micropackaging & Management Thermique

Compte tenu du succès renouvelé de l'édition 2010 et de la satisfaction largement exprimée des participants, IMAPS France prépare d'ores et déjà le 6e ATW Européen Micropackaging et Management Thermique et vous donne rendez-vous à La Rochelle les **2 et 3 février 2011**.